



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091113000
2009 年 11 月 20 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA(ハイパフォーマンシアナログ) IS0722x 製品 組立サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)		□Final notice	
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
	■Assembly	■Site	□Process	■Material
	Test	□Site	□Process	
	■Others	■Packing/Shipping/Labeling		□ -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンシアナログ) IS0722x 製品 組立サイト追加 現行 : HANA 社(HNT, タイ) 変更後: HANA 社(HNT, タイ), TI-Taiwan(台湾)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2010 年 2 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	■計画		□終了	
製品表示	□変更無し		■変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ30日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) IS0722x製品の組立サイトについて、現行 HANA社 (HNT, タイ) サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Taiwan (台湾) サイトを追加する予定です。部材の変更は下記を参照下さい。また、対象製品の信頼性試験計画及び2004年11月7日に完了しました代表パッケージ製品の信頼性試験結果につきましては、下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

組立サイト

現行

HANA社 (HNT, タイ)

変更後

HANA社 (HNT, タイ)

TI-Taiwan (台湾)

	現行	追加変更
組立サイト	HANA Thailand	TI-Taiwan
チップ接着剤	400154	4042500
モールド樹脂	450207	4205694
ボンディングワイヤ径	1.0 mil	0.96 mil

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
IS07220AD	IS07220BDRG4	IS07220MDR	IS07221BDG4	IS07221MD
IS07220ADG4	IS07220CD	IS07220MDRG4	IS07221BDR	IS07221MDG4
IS07220ADR	IS07220CDG4	IS07221AD	IS07221BDRG4	IS07221MDR
IS07220ADRG4	IS07220CDR	IS07221ADG4	IS07221CD	IS07221MDRG4
IS07220BD	IS07220CDRG4	IS07221ADR	IS07221CDG4	
IS07220BDG4	IS07220MD	IS07221ADRG4	IS07221CDR	
IS07220BDR	IS07220MDG4	IS07221BD	IS07221CDRG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記の様になる予定です。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	HANA Thailand	HNT
追加認定	TI-Taiwan	TAI



図1 出荷ラベルの例

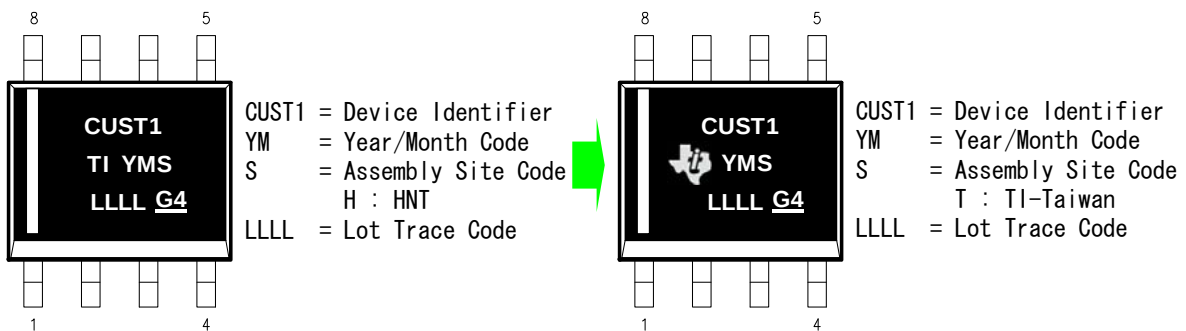


図2 捺印表示の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 7 月	終了	2009 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	ISO7220AD	Die #1, 2 Protective Coating:	11.5KNitride	
Die #1 Size (mm):	0.73 X 2.79	Die #2 Size (mm):	0.73 X 3.30	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.95 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		per spec	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77	
**T/C	-65/150C, 500, 1000 Cyc		85	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC Level-1 / 260C		12	
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-1 / 260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 7 月	終了	2009 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device-1	Device-2	Device-3	
Qualification Device:	ISO7220BD	ISO7220CD	ISO7220MD	
Die #1 Size (mm):	0.73 X 2.79	0.73 X 2.79	0.73 X 2.79	
Die #2 Size (mm):	0.73 X 3.30	0.73 X 3.30	0.73 X 3.30	
Die #1, 2 Protective Coating:	11.5KNitride	11.5KNitride	11.5KNitride	
Assembly Site:	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan	
Package Type/ Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	4042500	4042500	
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	
Bond Wire:	0.95 Mil Dia., Au	0.95 Mil Dia., Au	0.95 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device-1	Device-2	Device-3
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2009 年 7 月	終了	2009 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device-1	Device-2	Device-3	Device-4
Qualification Device:	ISO7221AD	ISO7221BD	ISO7221CD	ISO7221MD
Die #1 Size (mm):	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16
Die #2 Size (mm):	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16	0.73 X 3.16
Die #1, 2 Protective Coating:	11.5KNitride	11.5KNitride	11.5KNitride	11.5KNitride
Assembly Site:	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan
Package Type/Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8	SOIC/D/8	SOIC/D/8
Mount Compound:	4042500	4042500	4042500	4042500
Mold Compound:	4205694	4205694	4205694	4205694
Bond Wire:	0.95 Mil Dia., Au	0.95 Mil Dia., Au	0.95 Mil Dia., Au	0.95 Mil Dia., Au
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		Device-1	Device-2
			per spec	per spec
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		Device-3	Device-4
			per spec	per spec

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS2085D	Die Rev/Size (mils):	A/54 x 72 (dual die)	
Wafer Fab Site:	DFAB	Fab Process:	LBC4	
Passivation:	10KACN	Metal1-3:	AlSiCu	
Assembly Site:	TAI	Package Code/Pins:	D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	TS-2.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	MSL:	JEDEC,L1-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C,240 Hours	40/0	40/0	-
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	-
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 2000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-1 / 260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN75976A1DL	Die Rev/Size (mils):	B/301 x 122	
Wafer Fab Site:	HIJI	Fab Process:	LBC3S	
Passivation:	10KACN	Metal1-2:	TiW/AlSiCu 0.5%	
Assembly Site:	MLA	Package Code/Pins:	DL/56	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	TS-1.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	MSL:	JEDEC,L3-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-3 / 260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS2211ADB	Die Rev/Size (mils):	A/118 x 63	
Wafer Fab Site:	HFAB	Fab Process:	LBC3S	
Passivation:	10KACN	Metal1-2:	AlCu 0.5	
Assembly Site:	MLA	Package Code/Pins:	DB/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	TS-1.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	MSL:	JEDEC,L1-260C	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-1 / 260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS2201DB	Die Rev/Size (mils):	B/142 x 204	
Wafer Fab Site:	HIJI	Fab Process:	LBC2	
Passivation:	10KACN	Metal1-2:	AlCu 0.5	
Assembly Site:	MLA	Package Code/Pins:	DB/30	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	TS-2.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	MSL:	JEDEC,L1-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-1 / 260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	BQ3285ESS	Die Rev/Size (mils):	B2/88 x 105	
Wafer Fab Site:	TSMC2	Fab Process:	0.35u CMOS	
Assembly Site:	MLA	Package Code/Pins:	DBQ/24	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	TS-1.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	MSL:	JEDEC,L2-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycle s	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-2 / 260C				